2026/11/23線上法人說明會(中信證券)

富強鑫 (6603)

發言人：張銀鶯
電話：06-5950688#8877
E-mail:YING@fcs.com.tw

免責聲明

本資料由富強鑫精密工業股份有限公司(以下稱「本公司」)製作，且未經獨立查證。本簡報資料所提供資訊，包含前瞻性看法以及展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。這些前瞻性看法及展望可能因各種無法掌控的風險、不確定與不同假設等狀況而超出本公司的判斷，導致實際結果將可能有所出入或是不依預 期發生；讀者不應完全依賴此簡報資訊做其投資決策。

對於簡報中的內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責隨時提醒、更新或更正。本公司及其任何關係企業、顧問或代表人對於本資料中所呈現或包含之任何資訊造成的任何損失概不負責。

本資料中呈現或包含之資訊可不經通知加以變更，且不保證其正確性。本資料不構成證券發行邀約。

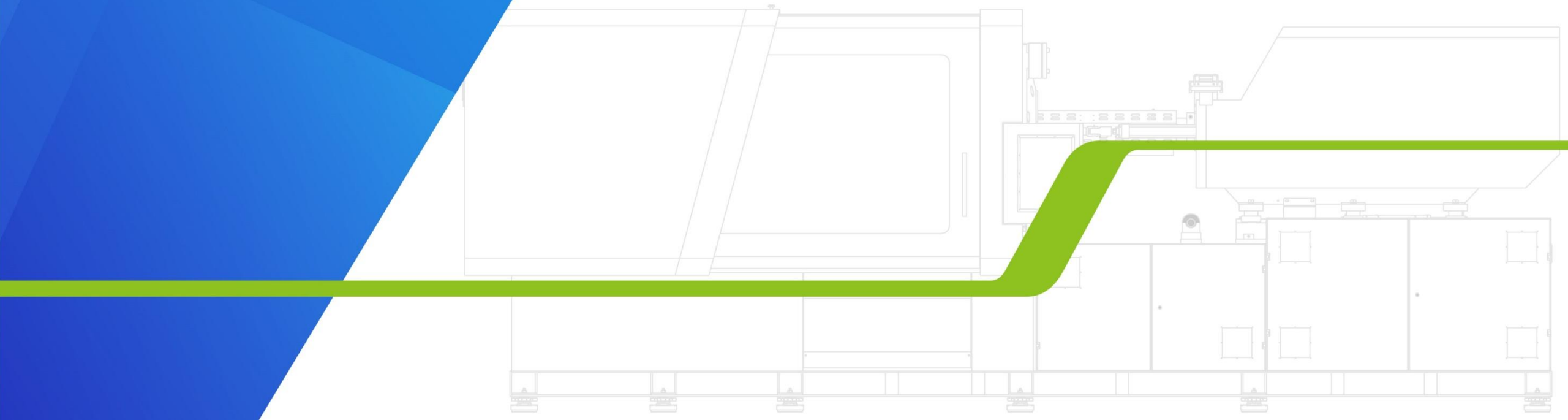
目　錄

一、公司簡介
二、市場機會
三、產品和客戶
四、競爭優勢
五、營運回顧
六、第二成長曲線

PART 01

公 司 簡 介

射出成型解決方案的提供者



關於 富強鑫

NT$50.8億
2025年集團營收
創新高

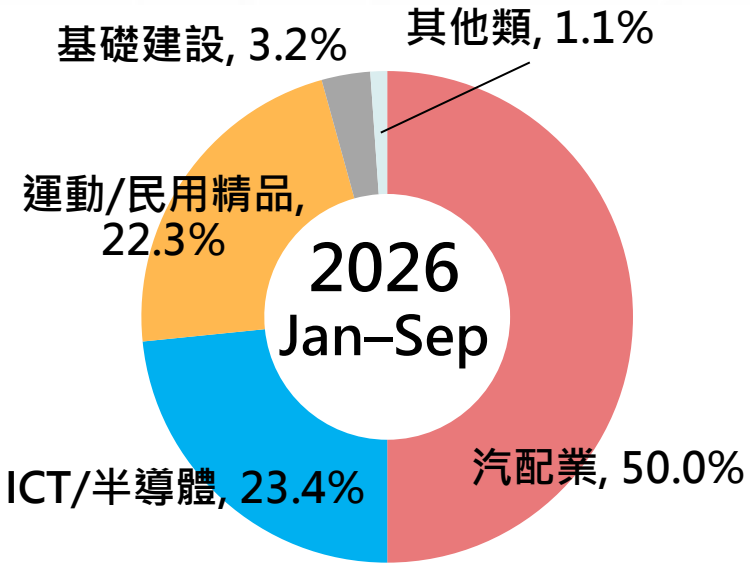
950+
全球員工數
專業團隊・創新成長

5座工廠
全球57個服務據點
全球36直營據點・21個代理據點

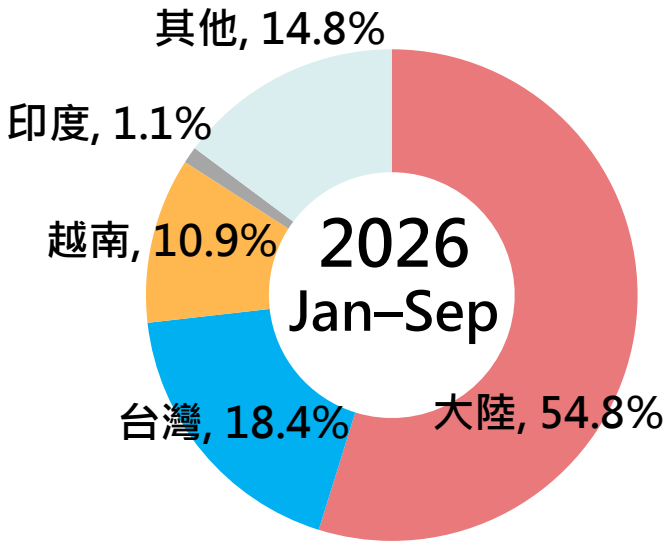
製造業排名578
2026年天下雜誌
台灣董事學會
2026年中堅潛力企業

研發投入
3%
占營收比例
致力創新・驅動未來

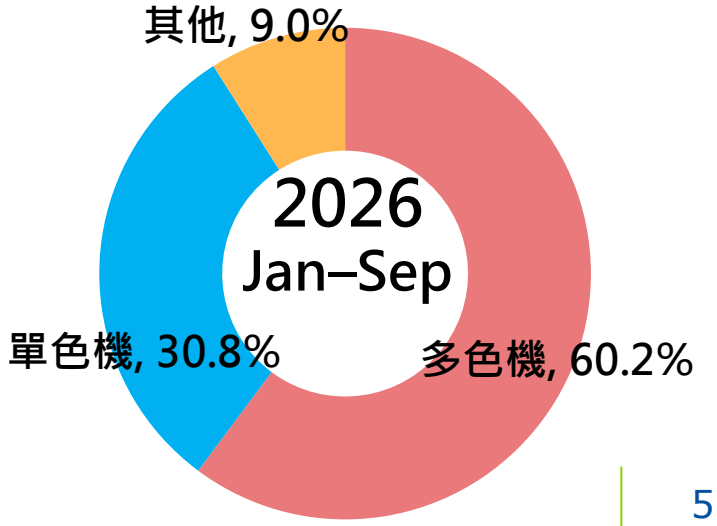
終端應用



銷售國別



產品別



富強鑫重要里程碑

深耕技術・全球布局・智慧轉型・永續未來

1974
成立富強鐵工所

奠定精密機械製造基礎



1978
投入塑膠射出機研發與製造

成為專業射出機廠商



1991
更名富強鑫(FCS)

建立國際品牌形象



2004
股票上櫃(6603)

邁入資本市場



2010
品牌升級為Solution Provider

射出成型解決方案提供者



2019
拓建全球生產基地及自營據點

服務據點超過50處



2020
推動智慧製造與工業4.0

建構智慧工廠及整廠解決方案



2026
智慧轉型永續未來

AI智慧製造・車用半導體・永續材料整廠解決方案



富強鑫發展三大階段

第一階段：創業與奠基(1974-1990)

- 成立富強鐵工所
- 投入塑膠射出機產業
- 建立台灣市場基礎



第二階段：全球布局(1991-2019)

- 更名富強鑫（FCS）
- 建立大陸及印度生產基地
- 股票上櫃（6603）
- 建立全球行銷服務體系



第三階段：智慧轉型・永續未來(2020至今)

- 智慧製造與工業4.0
- 深耕高附加價值產業
- 聚焦AI・智慧製造與永續發展



全球五大生產基地定位

深耕技術・全球布局・智慧轉型・永續未來

事業部 / 項目	台灣 富強鑫	東莞 富強鑫	寧波江北 富強鑫	寧波前灣 富強鑫	印度 富強鑫
產品定位	智慧產線整廠規劃 半導體設備專用機 永續材料專用設備 全電式射出機	多色射出機 單色射出機 ICT專用機	車用零組件射出機 中大型多色機	車用零組件射出機 中大型多色機 超大型多色機	車用零組件射出機 單色射出機
銷售區域	台灣、海外市場	大陸華南	大陸華東	大陸華東、華北	印度

台灣廠



- 智慧製造與研發總部
- 高階技術與創新產品開發

東莞廠



- 華南生產與供應中心
- 多元產品快速交付

寧波江北廠



- 華東生產與供應基地
- 車用與中大型產品專注

寧波前灣新區廠



- 高階多色機生產基地
- 超大型設備研發與製造

印度廠



- 印度市場在地製造
- 快速供應與服務支援

全球布局
五大生產基地協同運作

在地製造
提升效率・快速因應市場需求

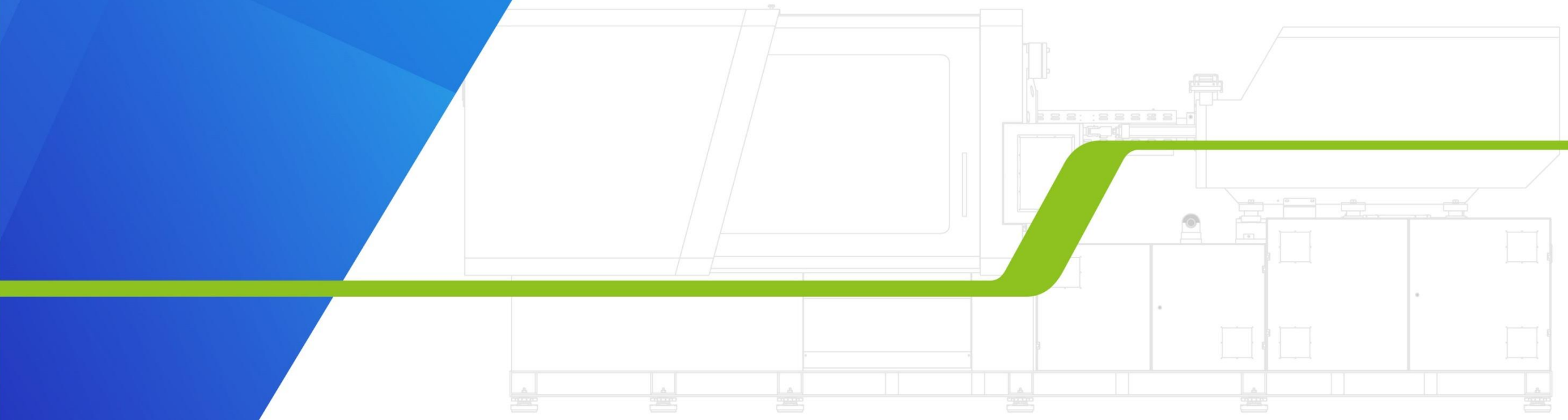
技術領先
持續創新・打造競爭優勢

永續發展
綠色製造・共創永續未來

PART 02

市 場 機 會

全球供應鏈遷徙x高階材料製程x工業軟體



全球供應鏈搬遷的「剛性設備需求」

大陸+1、美墨製造、東南亞擴廠；每一次新廠落地，都需要FCS新設備先行



舊設備進口限制創造換機需求

2025年越南營收達 4 億元

客戶新廠建置帶動高階機台輸出

墨西哥案例：全電機與多色機

日本上市巨頭 Unisol

北美代理與客戶開發

富強鑫不只是在賣機器，而是解決大廠複雜製程問題

1



多色機

營收佔比 60%

鎖模力最大達 3,500 噸；進入複雜外觀件與高階製程。

2



MuCell 物理發泡

去年出貨近 1 億元

成長一倍，預估今年再倍增；連結輕量化與減碳。

3



iMF 4.0

全球連線超過 1,000 台

從一次性售機延伸至資料、維護與持續服務收入。

多色成型市場與技術領先優勢

01 市場領先優勢



新能源車多色機市占率第一，達60%以上。

02 技術領先優勢



為中國《多色機裝備、多色機能耗檢測》之標準第一制定單位。

03 大型客戶實績優勢



全球前八大車燈廠，6家為富強鑫客戶。

04 整合解決方案優勢



整合「射出機＋模具＋智慧周邊＋成型技術」，提供客製化設計及整廠輸出的一站式服務。

iMF4.0:開啟 Industrial SaaS 成長引擎



數千個
工業資料節點

×



AI
品質監測・故障預診

×



持續
服務收入

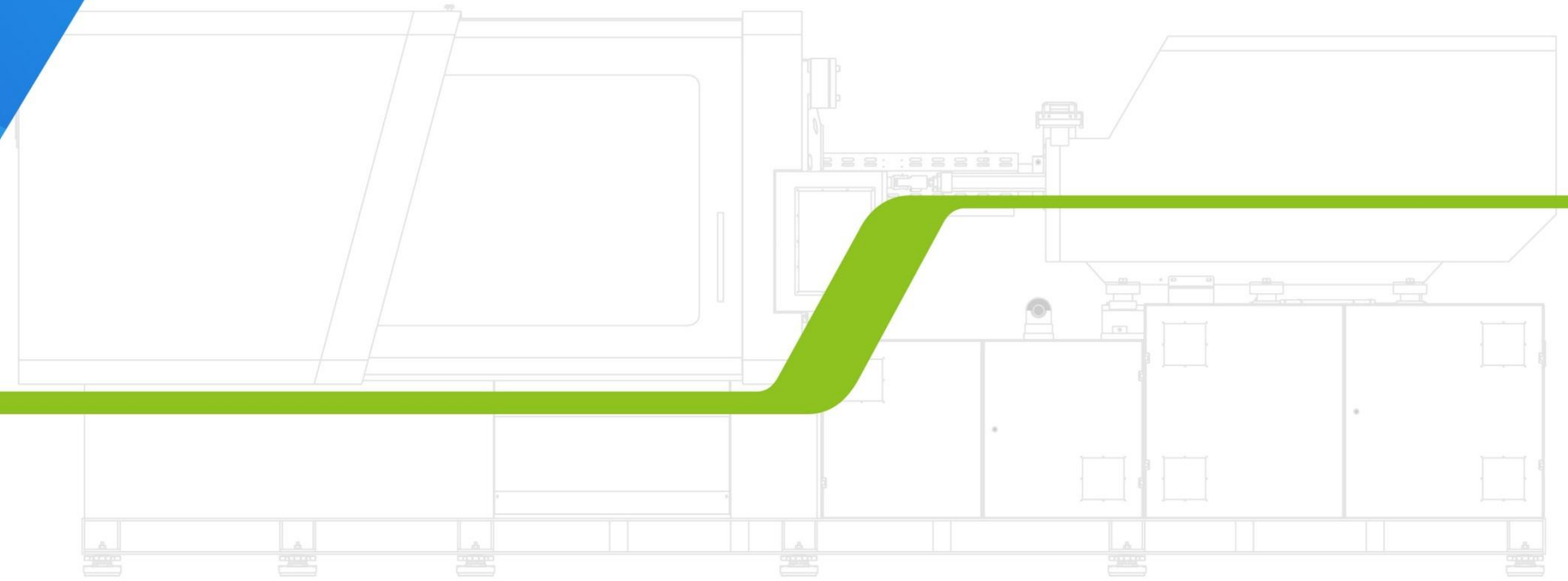


iMF 4.0 已連線全球超過 **1,000** 台客戶機台；
雲端與地端資料庫具備套裝購買與租用服務模式。

PART 03

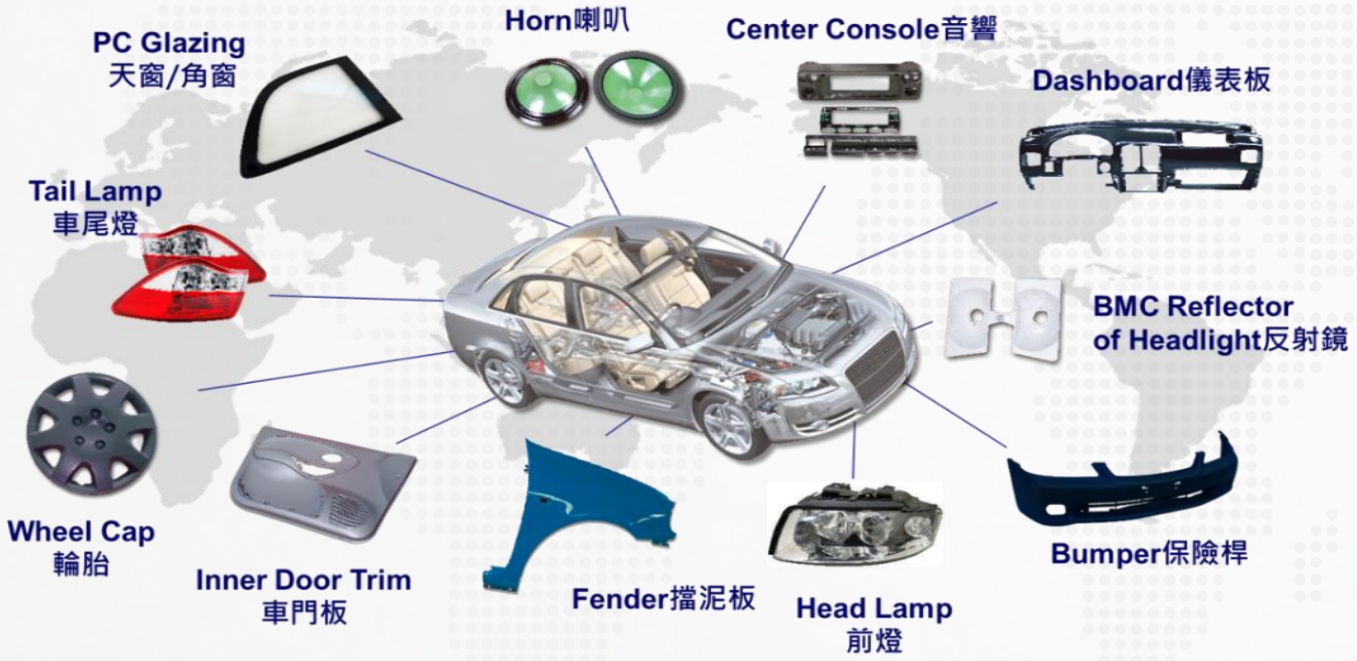
產品和客戶

多元布局，深耕產業



全球指標客戶

汽車零配件-營收占比50.0% (2026 Jan–Sep)



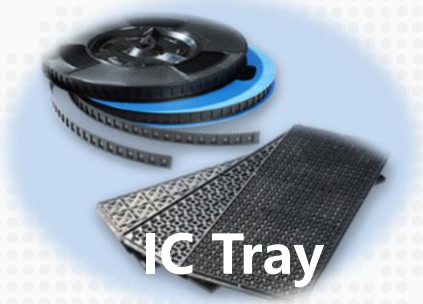
BMW · TESLA · VW · STANLEY · TOYOTA · HONDA · mazda · TYC · TYG · EAGLE EYES · DEPO · BYD · 广汽集团 GAG GROUP · 吉利汽车 GEELY AUTO · 星宇车灯 · LUMAX · SAIC 上汽集团 · TATA

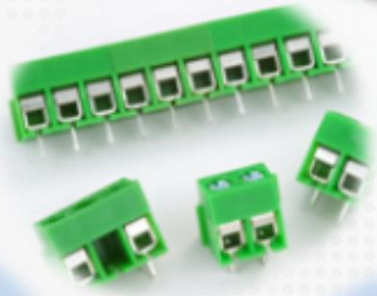
全球指標客戶

ICT 半導體/資通訊-營收占比23.4% (Q1-Q3 2026)















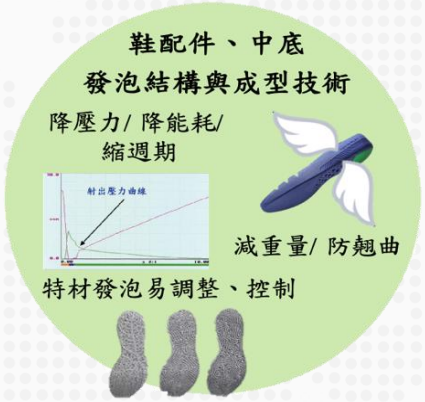
家登精密 Gudeng Precision
FOXCONN 富士康科技集團
PEGATRON 和碩聯合科技
日月光集團
樺塑企業 HWA SHU ENTERPRISE CO., LTD.
DELTA
士林電機 ShiLin Electric
Panasonic
Qisda 佳世达
Canon
泰金寶電通 Cal-Comp Electronics & Communications
LUXSHARE ICT 立讯精密
HUAWEI

全球指標客戶

運動/民用精品-營收占比22.3% (2026 Jan–Sep)













adidas

NIKE

豐泰企業

framas

DECATHLON 迪卡儂

宏福實業集團

CIRCLE

GIANT GROUP

TAROKO 昇明國際

CONVERSE

全球指標客戶

基礎建設-營收占比3.2% (2026 Jan–Sep)



自動倉儲





建 材





管件/閥門



南亞

日本積水 SEKISUI

SCH

越南 HOA SEN GROUP

Uni-Soleil 應誠

BIN TALEB

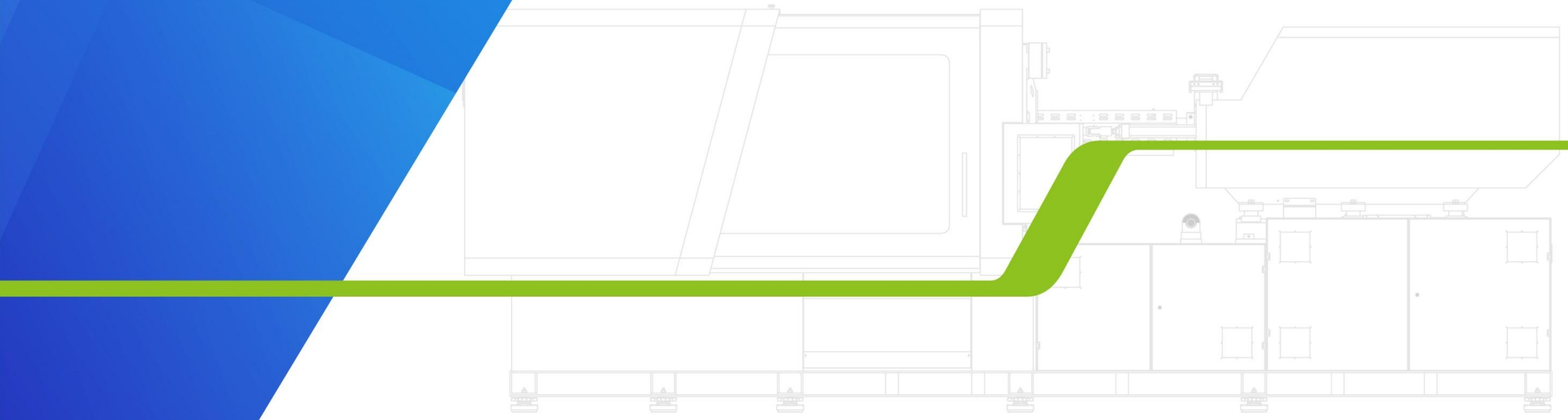
印度 Supreme People who know plastics best

Shaheen 沙烏地阿拉伯

PART 04

競爭優勢

軟硬兼備，一站俱足



具備客製化設計與整廠輸出能力

豐富整合經驗，提供一站式購足的加值服務

射出機、模具、智慧周邊和成型技術

01 掌握客戶需求
Understand Customer Needs

02 生產線規劃
Plant Layout Design

03 報價&整廠規畫書
Quotation & Proposal

04 產品設計
Product Design

05 設備開發
Equipment Development

06 整合測試
Integration Test

07 裝機&教育訓練
Installation & Training

08 專案驗收
Confirmation & Close





客製化設計
依客戶需求量身打造最佳解決方案

整廠輸出
從規劃到驗收，提供一站式整合服務

技術整合
射出機、模具、智慧周邊與成型技術完美整合

品質保證
嚴格測試與驗收，確保設備穩定可靠

新能源車 Turnkey 整廠規劃案例



中國
廣東

汽車
燈罩

178
台

23
萬噸

電競鍵盤-多色免塗裝、免印刷應用

中國
深圳

鍵盤

18台

5萬噸

德國知名製鞋大廠-整廠設備整合案例

framas indonesia







印尼

70台

鞋業

1.4萬噸

德國知名鞋業科技與射出成型品牌

歐美知名玩具品牌-印度整廠規劃案例





- **地點** 印度，班加羅爾
- **機台** 220台
- **鎖模力** 4萬噸

歐美知名品牌玩具製造公司

越南基建大廠-整廠規劃案例





- **地點** 越南 胡志明市
- **機台** 30台
- **鎖模力** 12萬噸

越南最有價值品牌 40 強，擁有11家大型工廠，近300家銷售據點。

台灣電子五哥-整廠規劃案例





- **地點** 越南
- **機台** 15台全電機
- **鎖模力** 0.3萬噸



富智康集團-整廠規劃案例





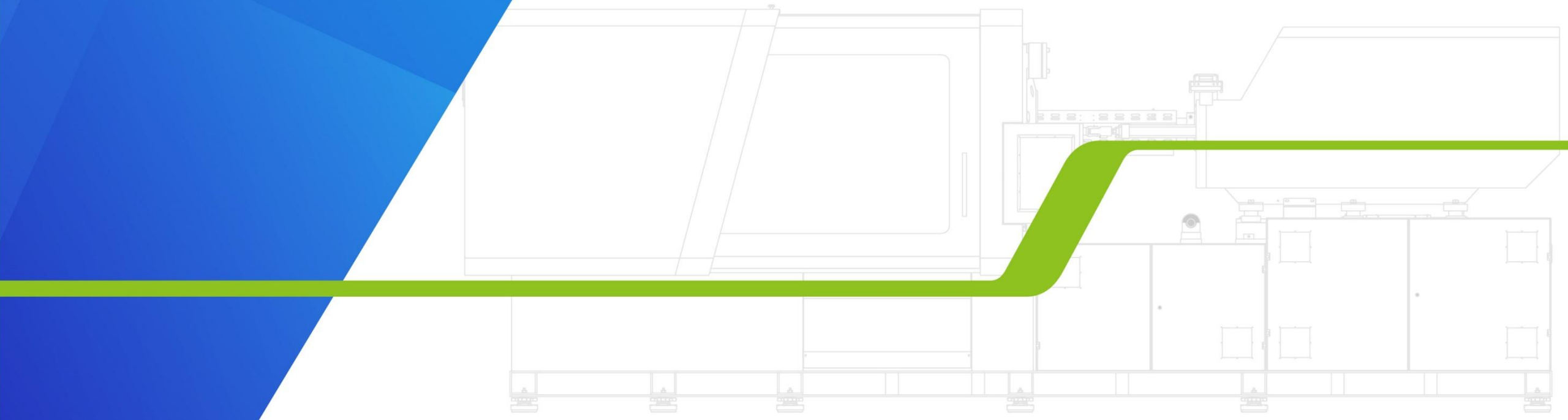
- **地點** Chihuahua墨西哥
- **機台** 14台全電機+2台多色機
- **鎖模力** 0.4萬噸



PART 05

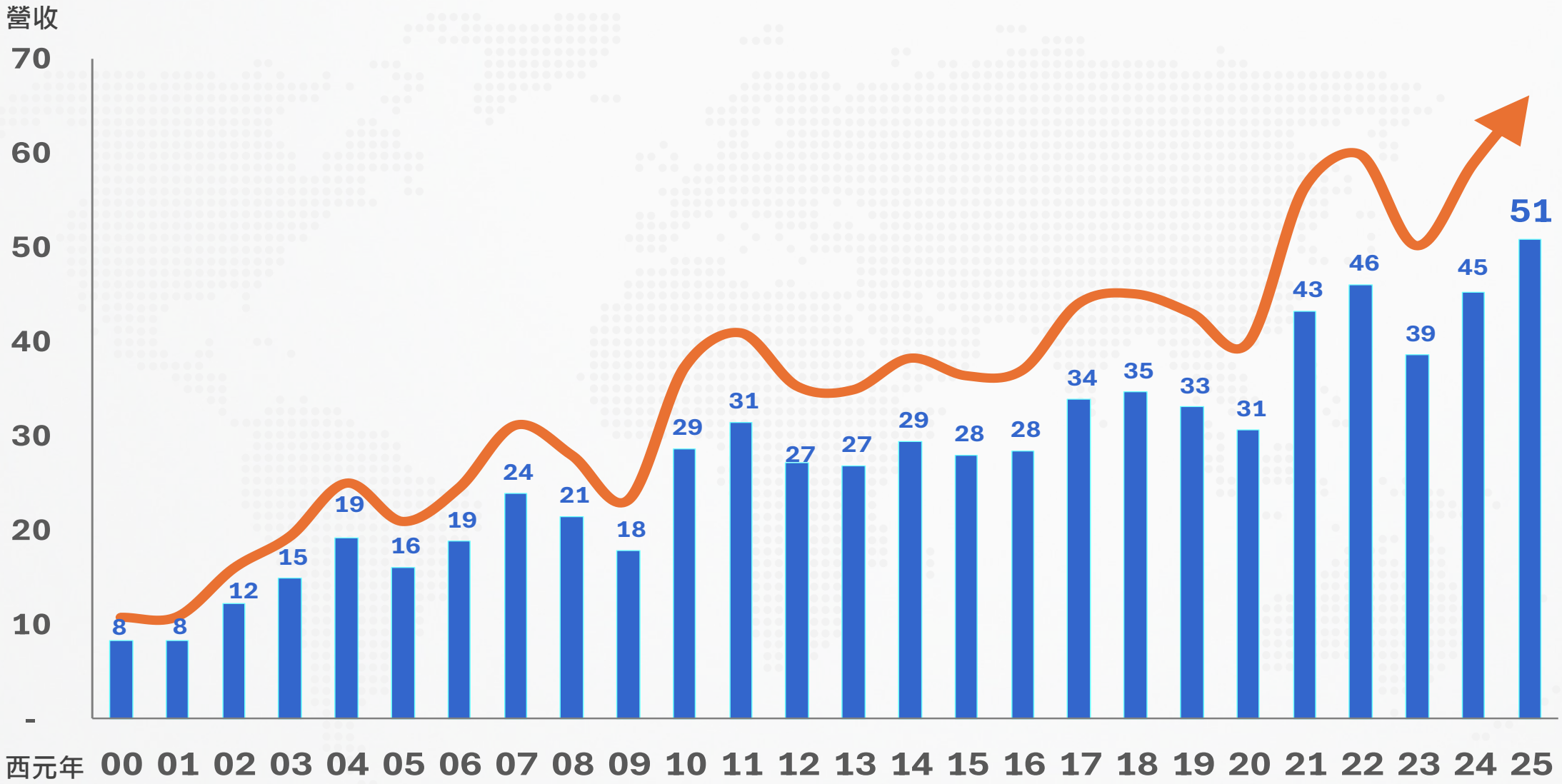
營運回顧

營技助益，售服馳援



營收成長

單位：NTD億元



合併損益表

單位： NTD千元

項目\年度	2024	2025	YOY	2025 Q3	2026 Q3	YOY
營業收入	4,529,411	5,082,840	12.22%	3,630,706	3,418,993	-5.83%
營業成本	3,369,271	3,795,423	12.65%	2,706,720	2,565,246	-5.23%
營業毛利	1,160,140	1,287,417	10.97%	923,986	853,747	-7.6%
毛利率	25.61%	25.33%	-0.28%	25.45%	24.97%	-0.48%
營業費用	1,039,567	1,082,496	4.13%	789,910	784,026	-0.74%
營業利益	120,573	204,921	69.96%	134,076	69,721	-48.0%
營業利益率	2.66%	4.03%	1.37%	3.69%	2.04%	-1.65%
業外收(支)淨額	11,611	-29,197	-351.46%	-40,907	1,189	-102.91%
合併稅前淨利	132,184	175,724	32.94%	93,169	70,910	-23.89%
所得稅(費用)	60,079	65,864	9.63%	41,048	31,481	-23.31%
合併稅後淨利	72,105	109,860	52.36%	52,121	39,429	-24.35%
稅後歸屬於母公司淨利	78,765	100,474	27.56%	44,888	36,607	-18.45%
EPS(元)	0.50	0.61	22.0%	0.27	0.22	-18.52%

合併資產負債表

單位： NTD千元

會計科目 \ 年度	2025.12.31		2025.9.30		2026.9.30	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及金融資產	960,102	11.3	998,364	12.1	1,096,854	12.5
應收款項	2,229,057	26.2	2,036,356	24.6	2,134,026	24.2
存貨	1,967,262	23.1	2,070,514	25.1	2,255,261	25.6
其他流動資產	321,671	3.8	206,899	2.5	215,816	2.5
不動產、廠房及設備、投資性不動產淨額	2,146,408	25.2	2,069,162	25.0	2,210,359	25.1
其他非流動資產	884,327	10.4	882,995	10.7	890,860	10.1
資產總計	8,508,827	100.0	8,264,290	100.0	8,803,176	100.0
流動負債	3,184,213	37.4	3,143,842	38.0	3,389,337	38.5
非流動負債	2,570,154	30.2	2,578,404	31.2	2,547,837	28.9
負債總計	5,754,367	67.6	5,722,246	69.2	5,937,174	67.4
股東權益總計	2,754,460	32.4	2,542,044	30.8	2,866,002	32.6
每股淨值（元）	**15.47**		**14.28**		**16.13**	

合併現金流量表

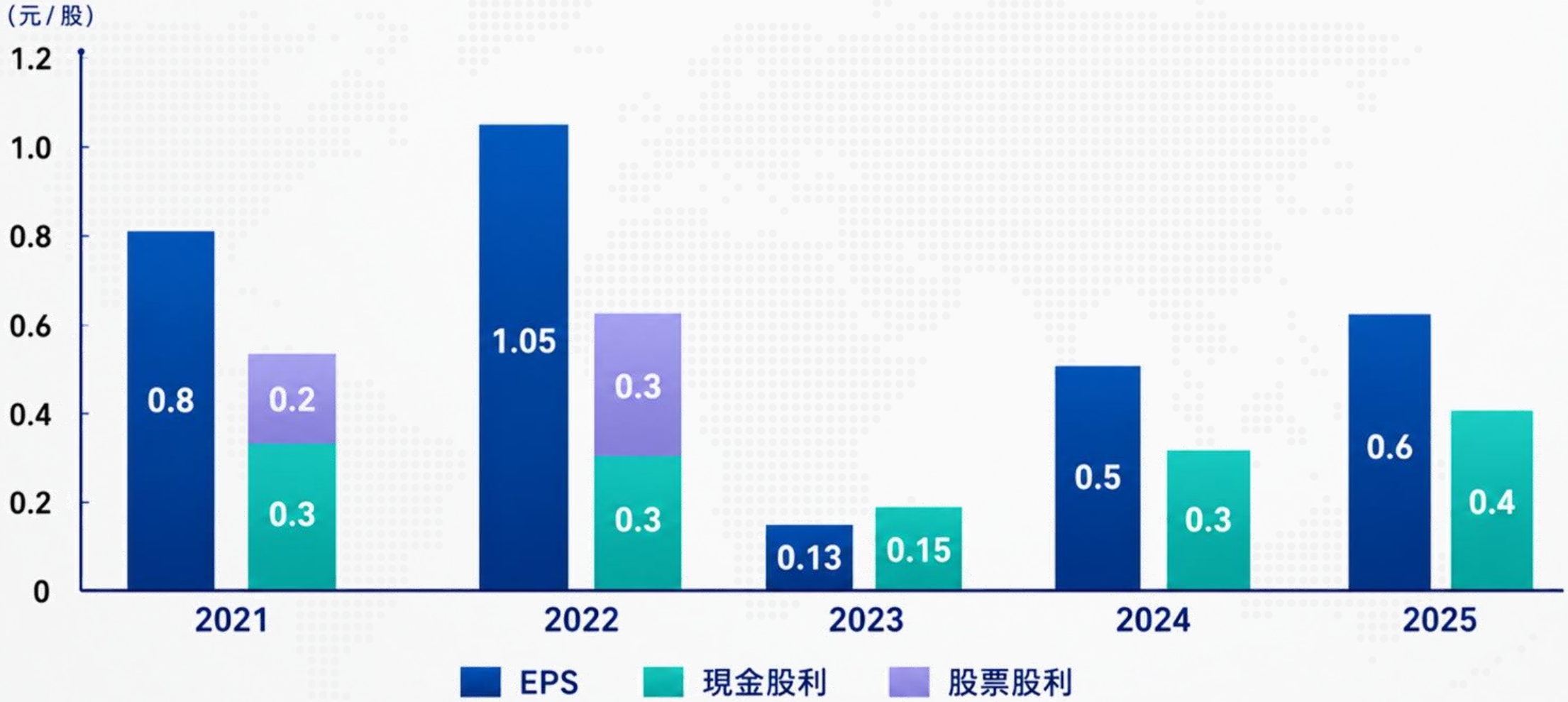
單位： NTD千元

項　　目	2025.9.30	2026.9.30	差異金額	差異(%)
期初現金及約當現金餘額	676,230	904,248	228,018	33.72
營業活動之淨現金流入(出)	-88,013	201,299	289,312	-328.72
投資活動之淨現金流入(出)	-3,507	-16,442	-12,935	368.83
籌資活動之淨現金流入(出)	302,298	15,995	-286,303	-94.71
匯率變動對現金及約當現金之影響	58,048	-24,751	-82,799	-142.64
本期現金及約當現金(減少)數	268,826	176,101	-92,725	-34.49
期末現金及約當現金餘額	**945,056**	**1,080,349**	**135,293**	**14.32**

財務比率分析

項目 \ 年度		2025.9.30	2026.9.30	2025.9.30 v.s. 2026.9.30
財務結構	負債佔資產比率(%)	69.24	67.44	-1.8
償債能力	流動比率(%)	168.97	168.23	-0.74
	速動比率(%)	103.11	101.69	-1.42
經營能力	應收款項週轉率(次)	0.72	0.62	-0.1
	存貨週轉率(次)	0.49	0.4	-0.09
獲利能力	**資產報酬率(%)**	10.67	0.16	-10.51
	權益報酬率(%)	2.19	0.49	-1.7
	純 益 率(%)	3.97	1.21	-2.76
	每股盈餘(元)	0.27	0.22	-0.05

股利政策　近五年配息率平均72%



2026年後續，將於全球各地舉辦4場展覽

月份	國家/地點	展覽名稱
11月	• 墨西哥/Mexico City • 印尼/Jakarta	• Plastimagen • PRI
12月	• 中國/深圳 • 土耳其/Istanbul	• 國際模具、金屬加工、塑膠及包裝展 • Plast Eurasia Istanbul

PART 06

加速集團第二成長曲線

布局AI半導體供應鏈，打造成長引擎

雙軌布局半導體新事業，加速集團第二成長曲線

布局高階 MLPC 及 AI 玻璃基板市場，以高階元件+設備代理，雙軌切入 AI / HPC 先進封裝供應鏈。

既有核心

精密射出成型機 + 智慧製造



- 海外布局 持續展現成效
- 軟體服務 同步升級

成長引擎 A

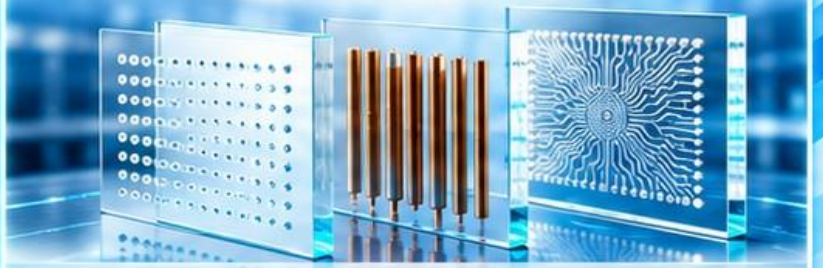
高階 MLPC 新事業



- GPU 穩壓 / 去耦合
- AI 伺服器 / AI PC
- 工控 AI 關鍵 電子元件

成長引擎 B

布局先進封裝 關鍵設備



- AI 玻璃基板
- TGV/ VP/VCP
- 先進封裝 關鍵設備

AI 關鍵零組件 ＋ 先進封裝設備

FCS | GROWTH ENGINE A

高階MLPC: 投資規模與市場預估

- 生產基地：FCS AI製造基地（V棟）
- 第一階段投資規模：新台幣 2 億元
- 市場年需求量 60 億顆，
  日系供應商市佔率 90%，
  進口替代商機可期。



資料來源：2026/9/7經濟日報

MLPC 疊層固態電容成長動能

AI 伺服器升級帶動高階電容需求，開創長期成長新動能

1. AI 伺服器帶動高階電容升級



- AI 伺服器功耗持續提升
- 高壓 MLCC 與 MLPC 固態電容需求同步成長
- 高容量、高耐壓、低 ESR 成為關鍵規格
- 帶動電源模組 (VRM) 升級需求

2. MLPC 固態電容核心優勢

高容量、高耐壓	• 支援高電流、高功率 AI 應用
低 ESR、低發熱	• 提升電源轉換效率 • 降低系統溫升
長壽命、高可靠度	• 適用 AI Server 長時間運作
穩定供電	• 提高 GPU、CPU 系統穩定性

3. 應用市場持續擴大

- AI Server
- GPU 加速卡
- 車用電子 (800V 高壓平台)
- 工業電源
- 5G 通訊設備
- 高效能運算 (HPC)

MLPC 固態電容已廣泛導入各大高成長領域

4. 市場發展趨勢

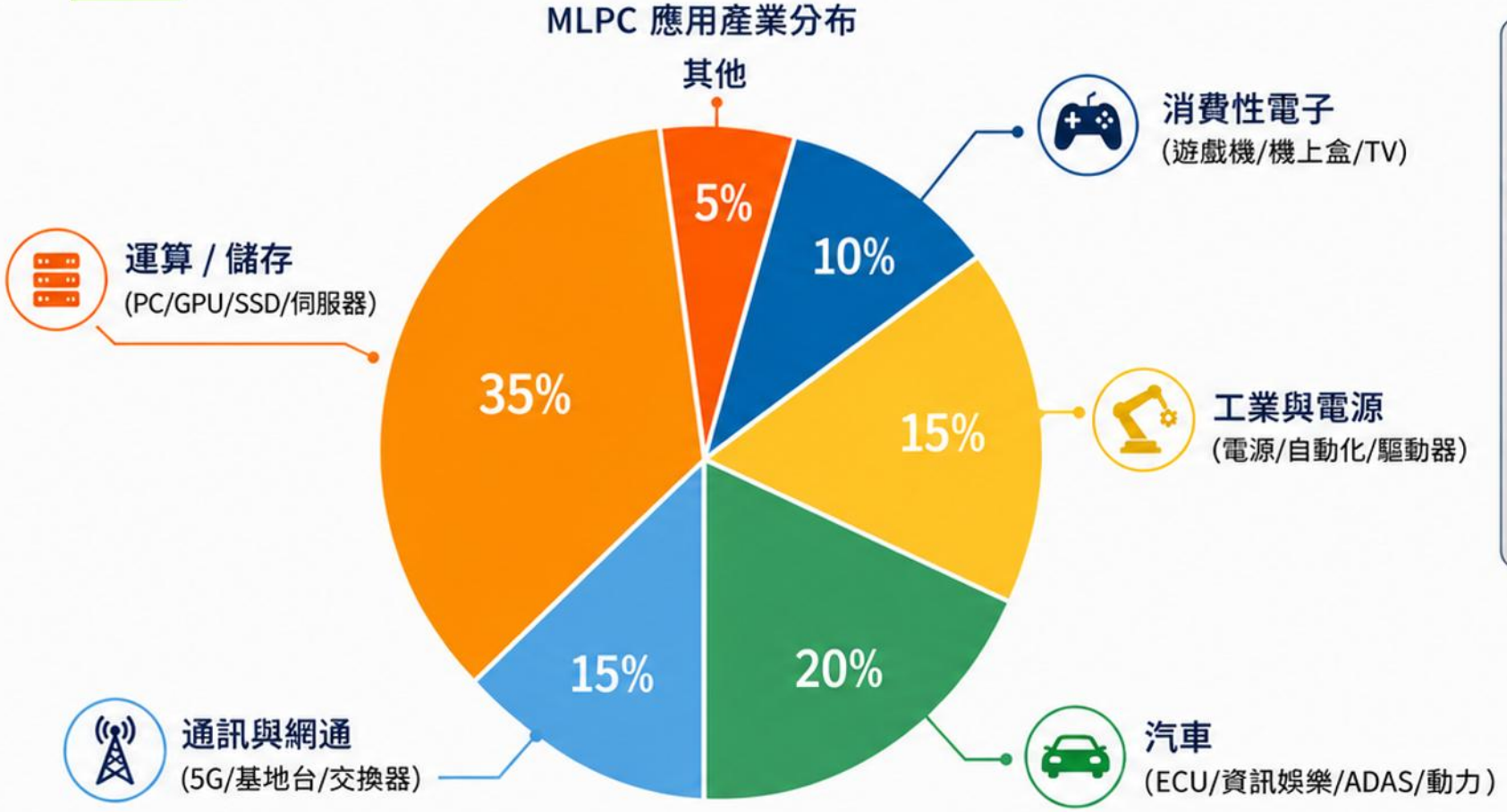
1. **AI 應用快速擴張** — AI、HPC 持續推動高功率需求
2. **電源架構持續升級** — VRM 架構升級，需要更高效電容
3. **固態電容滲透率提升** — MLPC 效能優勢明顯，滲透率持續提高
4. **高可靠度需求快速增加** — 長壽命、高可靠度成為關鍵競爭力

5. FCS 布局方向

- 聚焦 AI Server、GPU 與高功率電源市場
- 發展高容量、低 ESR、高耐壓 MLPC 固態電容
- 建立高可靠度產品與智慧製造能力
- 搶攻 AI 電源升級與進口替代商機

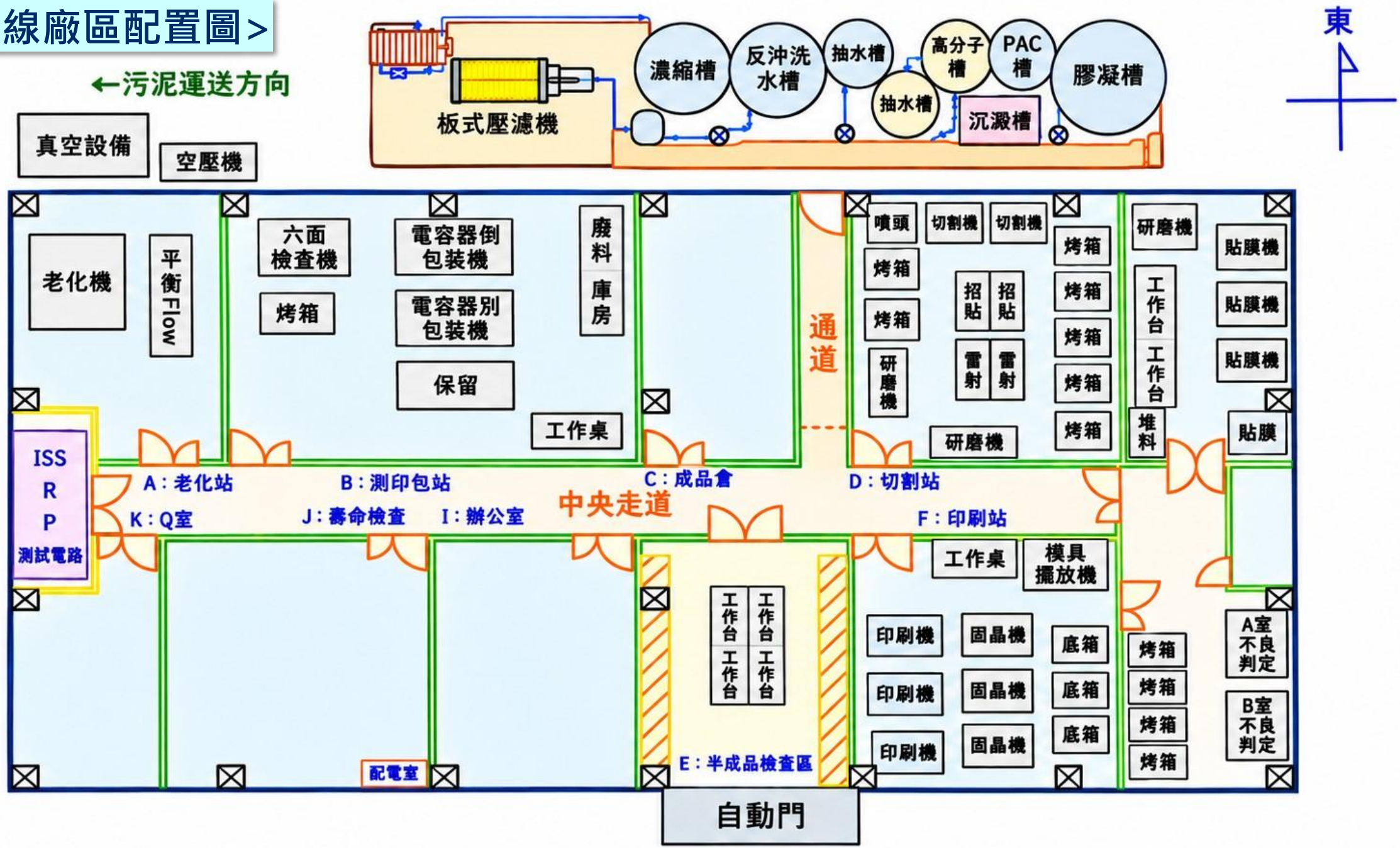
AI 應用擴大 × 電源升級 × 高可靠度需求，將持續帶動 MLPC 疊層固態電容 成為 AI 供應鏈的重要成長動能

應用領域分佈


MLPC 應用產業分布
其他
5%
消費性電子
(遊戲機/機上盒/TV)
10%
運算 / 儲存
(PC/GPU/SSD/伺服器)
35%
工業與電源
(電源/自動化/驅動器)
15%
通訊與網通
(5G/基地台/交換器)
15%
汽車
(ECU/資訊娛樂/ADAS/動力)
20%



<產線廠區配置圖>


←污泥運送方向
真空設備
空壓機
板式壓濾機
濃縮槽
反沖洗水槽
抽水槽
抽水槽
高分子槽
PAC槽
膠凝槽
沉澱槽
東
老化機
平衡Flow
六面檢查機
烤箱
電容器倒包裝機
電容器別包裝機
保留
廢料庫房
工作桌
通道
噴頭
切割機
切割機
烤箱
烤箱
烤箱
烤箱
烤箱
烤箱
烤箱
烤箱
研磨機
招貼
招貼
雷射
雷射
研磨機
研磨機
工作台
工作台
堆料
貼膜機
貼膜機
貼膜機
貼膜
ISS
R
P
測試電路
A：老化站
B：測印包站
C：成品倉
D：切割站
K：Q室
J：壽命檢查
I：辦公室
中央走道
F：印刷站
工作台
工作台
工作台
工作台
工作桌
模具擺放機
印刷機
印刷機
印刷機
固晶機
固晶機
固晶機
底箱
底箱
底箱
烤箱
烤箱
烤箱
烤箱
A室不良判定
B室不良判定
配電室
E：半成品檢查區
自動門

PART 06

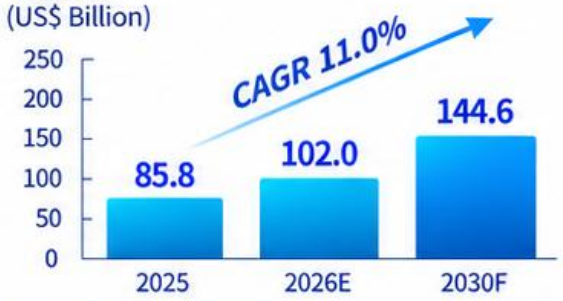
集團成長曲線B
半導體封裝設備

聚焦AI半導體供應鏈，打造成長引擎

AI驅動 CoWoS先進封裝升級

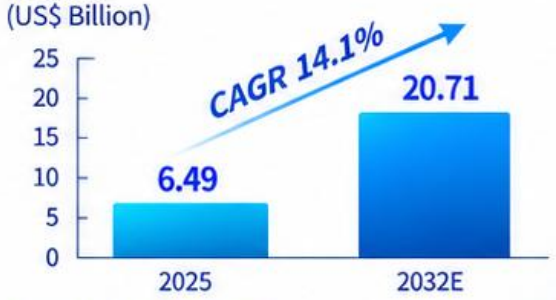
AI / HPC 帶動高階 PCB 需求，封裝基板世代升級，電鍍工藝持續演進

全球 PCB 市場



Source: Prismark, Q1 2026.

ABF 載板 (FC-BGA)



Source: Global Info Research (GIR),
"Global ABF (Ajinomoto Build-up Film) Substrate Market 2026," Jul. 2026.

1 ABF 載板面積放大與 CoWoS 封裝挑戰

產能虹吸效應

隨著大型語言模型等邁數兆參數門檻，NVIDIA 的 Blackwell 與 Rubin 架構要求採用 CoWoS 等先進封裝技術，帶動 ABF 載板需求大幅提升。

翹曲與熱應力難題

矽中介層 (Silicon Interposer) 面積不斷放大，導致載板面臨極大的翹曲與熱應力挑戰，ABF 載板必須增加層數與面積，長期處於供不應求的狀態。

2 破局技術：「玻璃基板」崛起

取代有機基板的物理極限

為了解決 ABF 載板尺寸封裝的翹曲難題，「玻璃基板」被視為革命性的替代材料。

核心優勢

玻璃材料具備超高剛性、極低翹曲率、優異的高頻電氣特性以及極佳的尺寸穩定性。

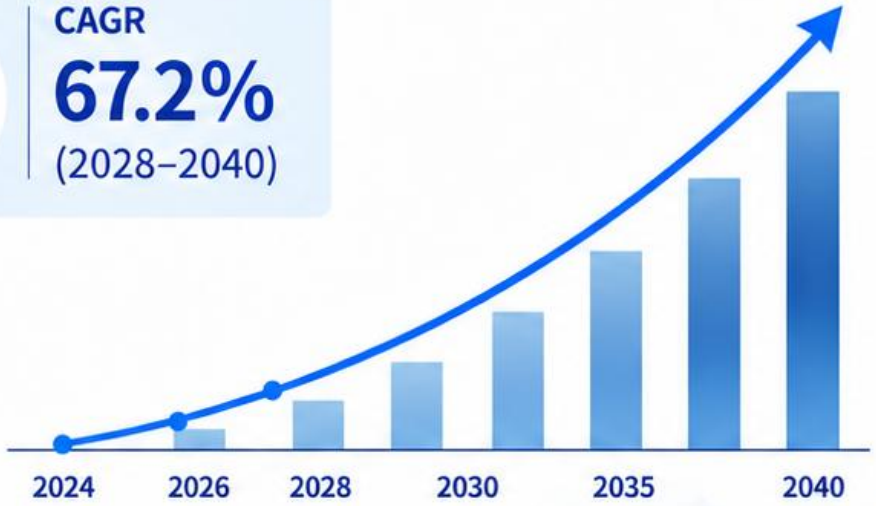
封裝基板五代演進：材料更替驅動電鍍工藝持續升級

第 I 代・陶瓷基板	第 II 代・BT 樹脂	第 III 代・ABF 積層膜	第 IV 代・矽中介層	第 V 代・玻璃基板
1950s–1970s	1980s–1990s	2000s–至今（主流）	2010s–至今（2.5D）	2020s–商業化元年
材料：氧化鋁/氧化鈹	材料：BT 樹脂	材料：ABF 積層膜	材料：矽中介層	材料：TGV + 面板級 RDL
封裝：DIP/QFP/PGA	封裝：PBGA/WB-BGA	封裝：FC-BGA/CoWoS-R	封裝：TSV + RDL 直布線 CoWoS/EMIB	封裝：Glass Core/CoPoS
電鍍：簡單通孔電鍍	電鍍：VCP 通孔填銅	電鍍：SAP/mSAP/微孔填銅	電鍍：TSV 深孔填銅 >10:1	電鍍：TGV 填銅
現況：布線密度 <200pin	現況：線寬 >40μm	現況：CTE 翹曲、DF	現況：成本高、難擴展	現況：大廠積極關注

玻璃基板 TGV 2028年進入量產關鍵期

全球玻璃基板市場規模預估

CAGR
67.2%
(2028–2040)



GNC Global Net Corp. | semi™

資料來源：SEMI・Global Net Corp. (GNC)・Glass Core Substrate Market and Development Trends, 2026.

全球玻璃基板市場發展時程

2025–2027	2028	2030+	2040
技術驗證 與中試線	初期商用量產 (特定高階 AI / HPC 應用)	加速導入 擴大應用	長期成長 潛在市場

台灣的機會

AI / HPC 驅動
高效能運算帶動先進封裝需求，玻璃基板成為關鍵解決方案

供應鏈整合
先進封裝產能與設備供應鏈集中於亞太地區，台灣具備製造與供應優勢

設備 / 材料 / 製程關鍵環節
切入 TGV・VP・VCP 等關鍵設備與材料，掌握下一波成長機會

高密度
更大尺寸

低翹曲
高穩定性

優異散熱
支援高效能應用

富強鑫 獨家代理 中科先峰設備

取得台灣及東南亞地區獨家代理權，切入半導體先進封裝市場

台灣 + 東南亞
獨家代理區域

20-25%
建置成本節省

鎖定下一代
AI 先進封裝市場

TGV | VP | VCP
關鍵製程設備

核心技術組合

韓國 核心研發
核心技術源自韓國半導體
大財團研發體系

蘇州基地生產
兼具技術指標與
成本競爭力

在地通路服務
整合大中華與東南亞
通路資源，提供即時服務

從 TGV 填孔到量產電鍍設備，建立完整設備切入點

01 TGV 玻璃通孔電鍍填孔設備
高長徑比
Void-free 無氣泡填孔

02 高階垂直生產設備 VP
One Bath One Panel
電鍍偏差控制 3% 內

03 高地垂直連續電鍍設備 VCP
高效能
大規模量產設備

SPP 高性能板級電鍍設備

面向多尺寸小試、中試及量產場景的先進面板級封裝電鍍整體解決方案

CKST
China Korea Smart Technology
ENABLING ADVANCED PACKAGING



01 設備介紹

中科先峰 SPP 為一款面向多尺寸小試、中試及量產場景的高性能板級電鍍設備，可針對高深寬比大尺寸玻璃基板開展 **TGV 填孔、銅柱（Cu-Post）及再分布局（RDL）** 超精細圖形電鍍工藝驗證；同時可用於專用電鍍液體系性能測試，以及電鍍藥水與量產工藝的適配性驗證等相關應用研究。

02 設備優勢

支援多尺寸應用
適用小試、中試到量產，滿足不同研發與生產階段需求

全製程工藝覆蓋
支援 TGV 填孔、Cu-Post、RDL 等關鍵電鍍工藝

高精度與高一致性
寬工藝範圍與智能化控制，確保穩定、可重複的電鍍品質

量產驗證與快速導入
支持批量化設備工況模擬，縮短工藝開發週期，加速實驗室工藝向量產轉化

03 關鍵規格

1	2	3	4	5
< 5 μm 線寬 / 線距製程能力	均勻一致性 < 3%	可處理玻璃基材	處理面板尺寸 515 × 510 mm	TGV 深寬比 ⩾ 10:1 （根據不同產品而定）

04 應用領域



TGV	Cu-Post	RDL	高附加價值基板
玻璃基板填孔	銅柱	再分布局	先進封裝應用

台韓合作布局玻璃基板設備

技術 × 通路結合，搶占 AI 先進封裝新市場

01

富強鑫 (6603) | CKST china korea smart technology 中科先峰

台韓合作
切入玻璃基板TGV

韓國領先玻璃基板設備技術
結合富強鑫市場通路，
搶占 AI 先進封裝新機會。

02



掌握客戶入口
拓展台灣 + 東南亞

導入 TGV／VP／VCP
玻璃基板製程設備，
切入台灣與東南亞市場，
擴大客戶版圖。

03



製造 + 售服
建立在地化優勢

結合設備製造、
自動化整合與全球售服能力，
滿足客戶在地化需求，
提升服務價值。

04



卡位 AI 先進封裝
加速第二成長引擎

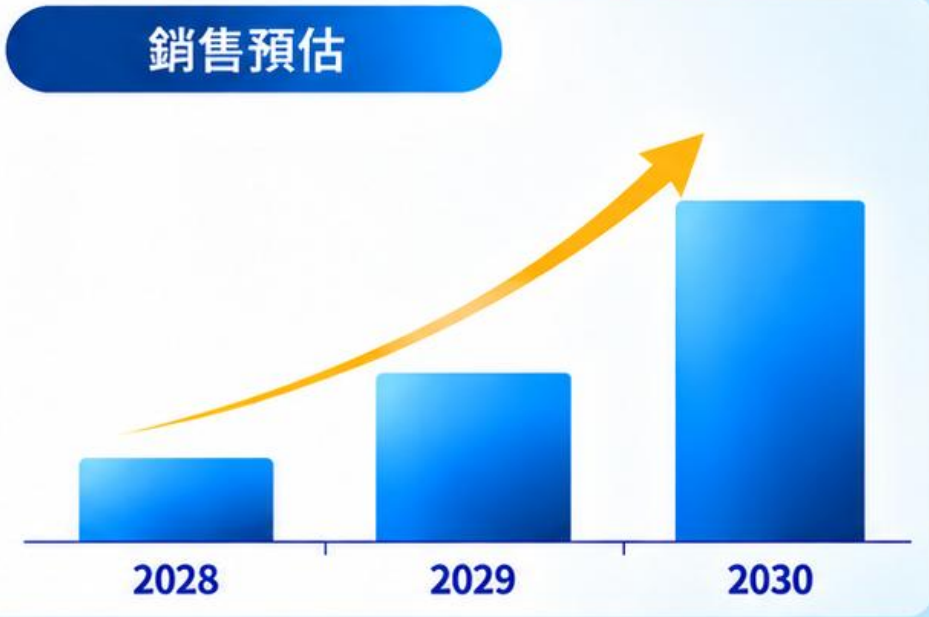
以玻璃基板切入
下一代先進封裝供應鏈，
滿足 AI 與 HPC 晶片需求，
創造長期成長動能。

「富強鑫不是單純設備代理商，
而是具備設備製造、自動化整合與全球售服能力的
產業合作夥伴。」

富強鑫 玻璃基板 TGV設備市場預估

掌握先進封裝趨勢，加速第二成長引擎

年度	TGV產值 (台幣億元)	設備占產值比例	設備需求 (台幣億元)
2028	300	80%	240
2029	1,500	35%	525
2030	2,400	35%	840



切入AI/先進封裝供應鏈

設備需求快速成長

加速半導體第二成長引擎

未來展望

01 提升 AI 營收占比

- 布局半導體高階被動元件與先進封裝市場
- 擴大全電式、高效節能機種
- 推動智慧工廠整合方案
- 強化 AI 應用與數位服務

02 提升獲利能力

- 持續改善毛利率與營運效率
- 提升 ROE 與自由現金流
- 強化全球營運管理

成為
智慧射出成型與
智慧製造解決方案的
全球領導品牌

03 全球市場成長

- 深耕印度、東南亞、美洲市場
- 擴大全球服務據點
- 提升海外營收占比

04 永續經營 (ESG)

- 推動低碳製造
- 節能減碳與循環經濟
- 建立智慧工廠與綠色供應鏈

全球布局
五大生產基地協同運作

在地製造
提升效率・快速因應市場需求

技術領先
持續創新・打造競爭優勢

永續發展
綠色製造・共創永續未來

FCS
www.fcs.com.tw

THANK YOU

訂閱最新動態

Copyright © 2025 FCS Group All Rights Reserved